

# LMP シンポジウム 2021

## レーザー加工技術の応用と最新動向（オンライン）

開催日：2021年2月19日（金）

開催方式：Zoom ウェビナー（Web 開催）

主 催

一般社団法人 日本溶接協会

企 画

レーザー加工技術研究委員会 (LMP 委員会)

(Laser Materials Processing Committee)

協 賛

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| ◆一般社団法人溶接学会    | ◆一般社団法人レーザー加工学会   |
| ◆一般社団法人日本鉄鋼協会  | ◆一般社団法人スマートプロセス学会 |
| ◆一般社団法人軽金属溶接協会 | ◆一般社団法人日本チタン協会    |
| ◆一般社団法人レーザー学会  | ◆公益財団法人日本金属学会     |
| ◆レーザー協会        | ◆ステンレス協会          |
| ◆中部レーザー応用技術研究会 | ◆産報出版株式会社         |

（順不同、依頼中含む）

### 〔 開 催 趣 旨 〕

近年、レーザー発振器に加えてレーザー加工用光学系、ロボットシステム、加工現象観察・診断装置などの周辺機器の開発が大きく進歩し、従来からの溶接、切断に加えてマイクロ加工、3Dプリンタに代表される積層など、レーザー技術が適用される加工技術の用途および分野は拡大しています。日本溶接協会 LMP 委員会では、レーザー加工技術の普及を目的として、2001年より毎年その時々の最新レーザー装置、加工技術、業界の動向などを紹介するレーザー加工シンポジウムを開催して参りました。今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、初めての Web 会議によるオンライン開催となりますが、最近注目されている各種レーザー加工装置、プロセスおよび応用例など、我が国におけるレーザー加工技術のトレンドを総覧いただける講演を1日の講演会として集約し、皆様にご紹介させていただき運びとなりました。

今回のシンポジウムでは、「レーザー加工診断技術」、「自動車分野での適用」、「最新のレーザー加工システムと実用例」、「動画による技術・装置紹介」の4つのセッションで、それぞれ3~4件ずつ各分野を代表する専門家の方々に講演していただきます。現状のレーザー加工のトレンドを総覧できるような講演を選出いたしましたので、本シンポジウムを聴講いただくことで国内のレーザー加工技術の動向を把握いただけるかと存じます。特に、「動画による技術・装置紹介」のセッションは、恒例となっていました見学会の代わりとして、レーザー加工装置とその使用例を動画でご覧いただくことで最新のレーザー加工を実感していただけるように企画いたしました。

是非この貴重な機会をご利用いただき、皆様の今後のレーザー溶接・レーザー加工の導入検討あるいは更なる新技術開発を行う一助としていただければと思います、ここにご案内申し上げます。

【プログラム】

09:00～09:10	開会挨拶、シンポジウム聴講上のご注意	レーザ加工技術研究委員会 委員長 片山 聖二 氏
<b>セッション 1 【レーザ加工診断技術】</b>		司会：富田 直良 (㈱ダイヘン)
09:10～09:40	高速度カメラによるレーザ加工観察	(㈱)ナックイメージテクノロジー 小堀 健介 氏
09:40～10:10	産業用レーザビーム解析の最新動向－オフライン計測から加工装置へのインテグレートへ	PRIMES Japan(㈱) 佐倉 正和 氏
10:10～10:40	アルミ材のリモート溶接と『e-Mobility』におけるモニタリングの最新状況の紹介	プレシテック・ジャパン(㈱) 牛山 直幸 氏
10:40～10:50	休憩 (10分)	
<b>セッション 2 【自動車分野での適用】</b>		司会：松山 秀信 (日産自動車(株))
10:50～11:20	電気自動車用パワートレイン部品のレーザ加工アプリケーション (Laser processing application for powertrain parts for electric vehicles)	日産自動車(株) Funar Aurel 氏
11:20～11:50	自動車部品へのレーザ溶接の適用と 3D プリンタの開発状況	(㈱)日立製作所 宮城 雅徳 氏
11:50～12:20	自動車部品におけるレーザ溶接適用と最近の進歩について	(㈱)デンソー 白井 秀彰 氏
12:20～13:10	昼食休憩 (50分)	
<b>セッション 3 【最新のレーザ加工システムと実用例】</b>		司会：皆川 邦彦 (レーザーライン(株))
13:10～13:40	ダイレクトダイオードレーザを用いた加工システムの新展開	パナソニック スマートファクトリーソリューションズ(株) 西村 仁志 氏
13:40～14:10	「スパッターフリー」青色レーザ溶接・加工の紹介	(㈱)オプトサイエンス 脇田 和則 氏
14:10～14:40	青色レーザを用いた銅溶接技術	(㈱)片岡製作所 林 佳佑 氏
14:40～15:10	パウダーベッドフュージョン式金属 3D プリンタ品質改善ソリューション	(㈱)プロフィット 奈良 拓治 氏
15:10～15:25	休憩 (15分)	
<b>セッション 4 【動画による技術・装置紹介】</b>		司会：木谷 靖 (JFE スチール(株))
15:25～15:55	高出力ダイレクト半導体レーザによる加工応用技術開発の最前線	レーザーライン(株) 武田 晋 氏
15:55～16:25	レーザックスが提供するレーザ加工技術	(㈱)レーザックス 駒形 方彦 氏
16:25～16:55	量産ツールとしてのファイバーレーザ発振器と周辺機器の紹介	IPG フォトニクスジャパン(株) 住森 大地 氏
16:55～17:00	閉会挨拶	レーザ加工技術研究委員会 副委員長 西村 仁志 氏

【ご留意事項】

- ・開始時間の 30 分前より随時シンポジウム URL へアクセスいただけます。事務局の方で参加者名を確認後、シンポジウム開催ルームへの入室許可作業を行います。アクセス方法の詳細は別途ご連絡いたします。
- ・講師およびスケジュールについては、やむを得ない事情により変更になる場合があります。  
最新情報は LMP 委員会 Web サイト (<http://www.jwes.or.jp/lmp/>) にてご確認ください。

# 〔 開催要領 〕

## 1. 日 時

2021年2月19日（金）9:00～17:00

## 2. 定 員（※申込先着順とし、定員に達し次第締め切らせていただきます。）

120名

## 3. 参加料（テキスト代（PDF）・消費税を含む）

会 員※	非会員
15,000円	20,000円

※上記料金は参加者1名分となります。料金にはテキスト代（PDF）・消費税を含みます。

※会員とは、日本溶接協会団体会員会社（<http://www-it.jwes.or.jp/kain/kaindsp.jsp> 参照）にご所属の方を指します。

## 4. 申込期限

2021年2月12日（金）（ただし、定員に達し次第〆切）

## 5. 申込要領

(1) お申込は以下の当協会 講習会・シンポジウムオンライン受付ページよりお願い致します。

➤ <https://www-it.jwes.or.jp/seminar/>（右側記載のQRコードからもアクセスいただけます）

※当協会ホームページ「お知らせ・募集」（<http://www.jwes.or.jp/>）にも案内を掲示しております。



(2) 入力いただいた個人情報は「個人情報保護に関する法律」に則り当協会が定めた個人情報保護方針に従い管理します。詳細は「一般社団法人 日本溶接協会 個人情報保護方針」（<http://www.jwes.or.jp/privacy.html#info>）をご参照ください。

(3) 受付手続完了後に当協会よりお送りする受講確定メールに「受講番号」が記載されております。当日シンポジウムのZoom会議室に入室される際の表示名に受講番号を入力いただきますので、お手数ですが当日までメールを保管くださいますようお願い申し上げます。

(4) 受講確定メールをご確認の上、参加料を以下の口座へお振込みください。

**お振込先：三井住友銀行 神田駅前支店 普通 No.0146921（一社）日本溶接協会 シヤニホソウゲツキョウカイ**

※振込手数料は貴社にてご負担ください。※原則として、口座へのご入金をもって領収に代えさせていただきます。請求書又は領収書の発行を希望される場合は、申込の際に「摘要欄」にてお知らせください。郵送にてお送りします。

(6) お振込後の参加費は返金致しません。ご欠席の場合は、代理出席をお願い致します。

(7) 開催1週間前までにメールにてテキストPDFダウンロードのご案内をお送りします。未着の場合は事務局までご連絡ください。

## 6. 事務局（問い合わせ／申込先）

一般社団法人日本溶接協会 業務部 下園（シモヅノ）

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 4-20 TEL：03-5823-6324 FAX：03-5823-5244

## 7. 開催方針

Zoom ウェビナーによる Web 会議開催といたします。当日会議室に入室する要領（ミーティング ID とパスワード）はお申込みいただいた方へ開催 1 週間前をめぐりに送付します。また、聴講に必要な Zoom の操作、聴講に際しての注意事項などの案内も併せて送付する予定です。会場に集合しての開催はございませんのでご注意ください。

## 〔オンライン開催にあたってのご確認・注意事項〕

今年度は以下の要領にてシンポジウムをオンライン開催いたします。会場に集合しての開催はございません。お申込み前に十分ご確認ください。聴講に関する操作等の詳細は、お申込みいただいた方へ後日案内します。

### 1. 利用システム

Zoom ウェビナー (<https://zoom.us/jp-jp/webinar.html>)

### 2. 受講者側で準備いただくもの

- ・インターネット環境
- ・上記に接続されている PC、スマートフォン、タブレット

※受講者側ではカメラを使用しませんので、準備いただく必要はありません。質疑応答ではマイクで発言いただきますので、マイクは必要に応じて事前にご準備ください。聴講、発言時の音声品質の確保のためには、ヘッドセット、イヤホンマイクの使用を推奨いたします。

- ・Zoom アプリ

※Zoom はブラウザでも使用できますが、一部の機能が制限されるためアプリでの参加を推奨いたします。予めご使用される PC に Zoom アプリをインストールしておいていただければと存じます。

※Zoom 使用のためのシステム要件は以下を参照ください。

<https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023>

### 3. 禁止事項

- ・申込者ご本人以外も自由に閲覧できるような環境（例：仕切りのないオープンスペース、テレビやスピーカーでの映像・音声放送）での受講をご遠慮ください。
- ・シンポジウム配信画面の記録（撮影・録音・録画・スクリーンショットの取得その他一切の手段による）および講演内容の無断転用・無断転載を禁止します。

### 4. Zoom ウェビナーへの参加方法

- ・Zoom ウェビナーの会議室入室に必要な情報および画面操作案内は、お申込みいただいた方へ後日メールで配信します。

### 5. 重要なご案内

- ・新型コロナウイルス感染症の拡大状況またはその他の事情により、講師変更またはシンポジウム開催中止となる場合がございます。万が一シンポジウム開催中止の場合は参加料を全額返金致します。
- ・最新情報は当協会 レーザ加工技術研究委員会ホームページ (<http://www.jwes.or.jp/lmp/>) にて随時ご案内します。ご確認の程宜しくお願い申し上げます。

以上